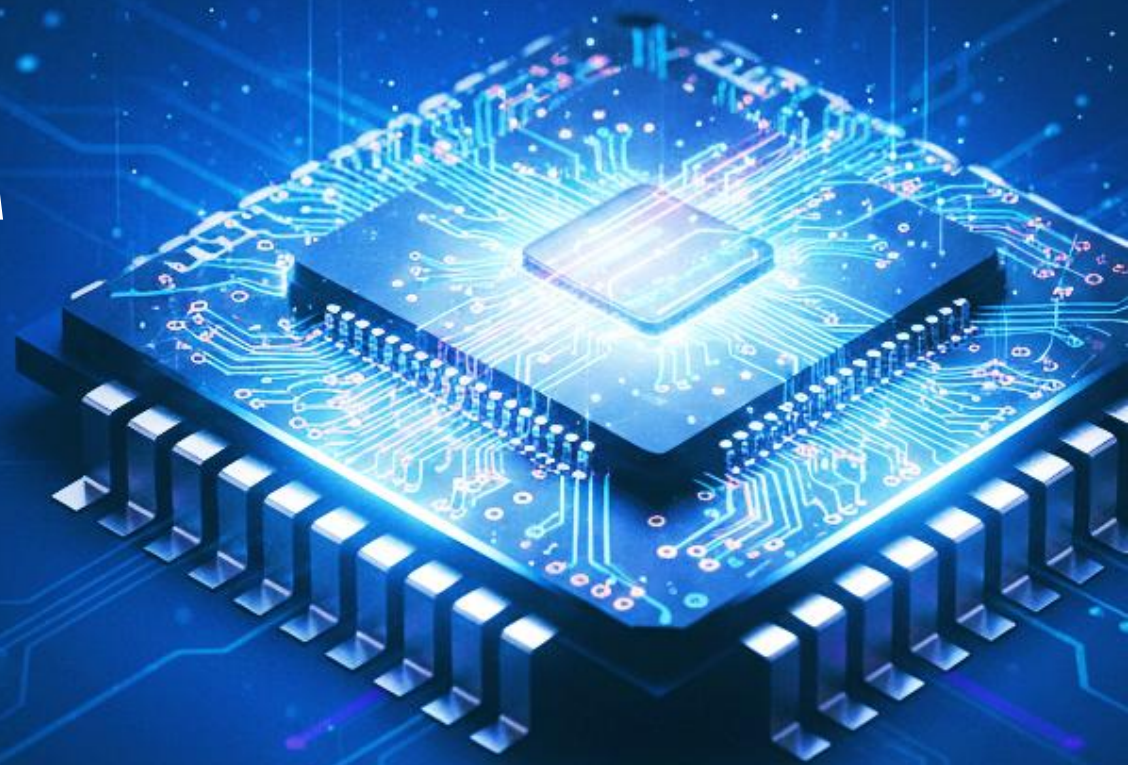


2026 Investor Relations

Global Solution Provider

DONGJIN SEMICHEM



 **DONGJIN SEMICHEM CO.,LTD.**

Table of Contents

01

Dongjin Semichem Highlight

02

Prologue

- CEO Message
- History & Governance
- Global Network

03

Core Business & Competitiveness

- Semiconductor Materials
- Display Materials
- Green Energy
- Growth Strategy & Momentum

04

Financial Performance

- Financial Summary
- Financial Structure
- Shareholder Return

05

Appendix

초미세 공정의 한계를 넘다

글로벌 첨단소재 솔루션 프로바이더 동진세미켴

초격차 독점 벤더 (EUV 포토레지스트 양산)



- ✓ 국내 최초 EUV 포토레지스트 양산을 성공하면서 일본 기업이 독점하던 시장에서 독보적인 기술적 해자를 구축
- ✓ 현재 주력 제품인 KrF PR은 NAND 고단화 공정에 비례하여 사용량이 증가하는 독점적 지위를 확보
- ✓ 범용 소재인 신너 또한 DRAM 업사이클 수혜를 입어 '24~'25년의 NAND 수요 약세 속에서도 반도체 소재 부문의 높은 성장을 증명

미국 시장 진출 및 중장기 성장 동력 확보



- ✓ 동진세미켴은 약 2,600억원을 투자한 미국 텍사스주에 건설한 신너 및 고순도 황산 공장을 통해 글로벌 반도체 공급망 내 입지를 대폭 강화 중
- ✓ 26년 하반기 양산이 예정된 신너 공장은 이미 대형 수주를 확보한 파운드리 고객사의 현지 공장에 납품 예정
- ✓ 삼성물산 및 마틴(Martin)과 합작 설립된 고순도 황산 공장은 미국 정부의 소재 자립화 정책에 따른 수혜를 누릴 전망

Prologue

- CEO Message
 - History & Governance
 - Global Network
-

Silicon Park
실리콘 파크

(주)동진세미켐
DONGJIN SEMICHEM

CEO Message



정밀화학소재 분야에서 세계 일류 기업이 되기 위하여 최선을 다하겠습니다.

당사는 순수 국내 자본으로 성장한 기업으로서 국내 전자재료의 국산화에 앞장섰으며, 국내 반도체, 디스플레이 산업이 세계 1위로 도약할 수 있는데 기여한 바가 많았습니다. 앞으로도 점점 첨단화, 고도화되고 있는 전자산업에서 그동안 축적해 온 기술력을 바탕으로 화학재료 분야에서 최고의 회사로 성장해 나가겠습니다.

또한 차세대 신성장 동력으로 지난 수년간 연구개발을 하고 있는 친환경 에너지 분야를 비롯하여 수많은 연구의 결실을 통해 사업분야를 지속적으로 넓혀 나갈 준비를 마쳤습니다.

이제는 보다 큰 도약을 위해 저희 임직원은 불철주야 노력을 기울일 것입니다. 고객과 주주 여러분들의 믿음과 격려를 부탁드립니다. 앞으로 지속적으로 성장하는 동진세미켐의 모습을 기대해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

대표이사 회장 이준혁

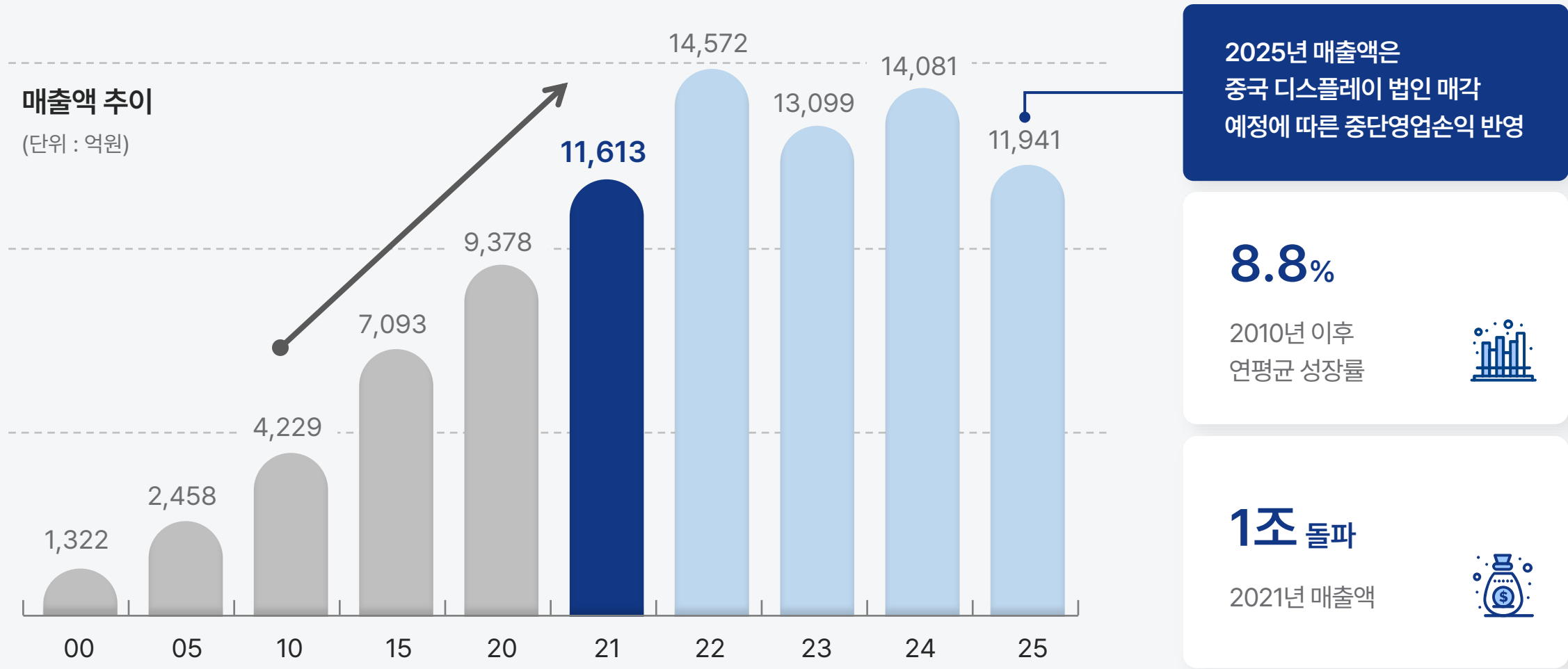
History & Governance

동진세미켄은 지난 반세기 동안 국내 정밀화학소재 분야의 전문기업으로 꾸준히 성장해 왔습니다.



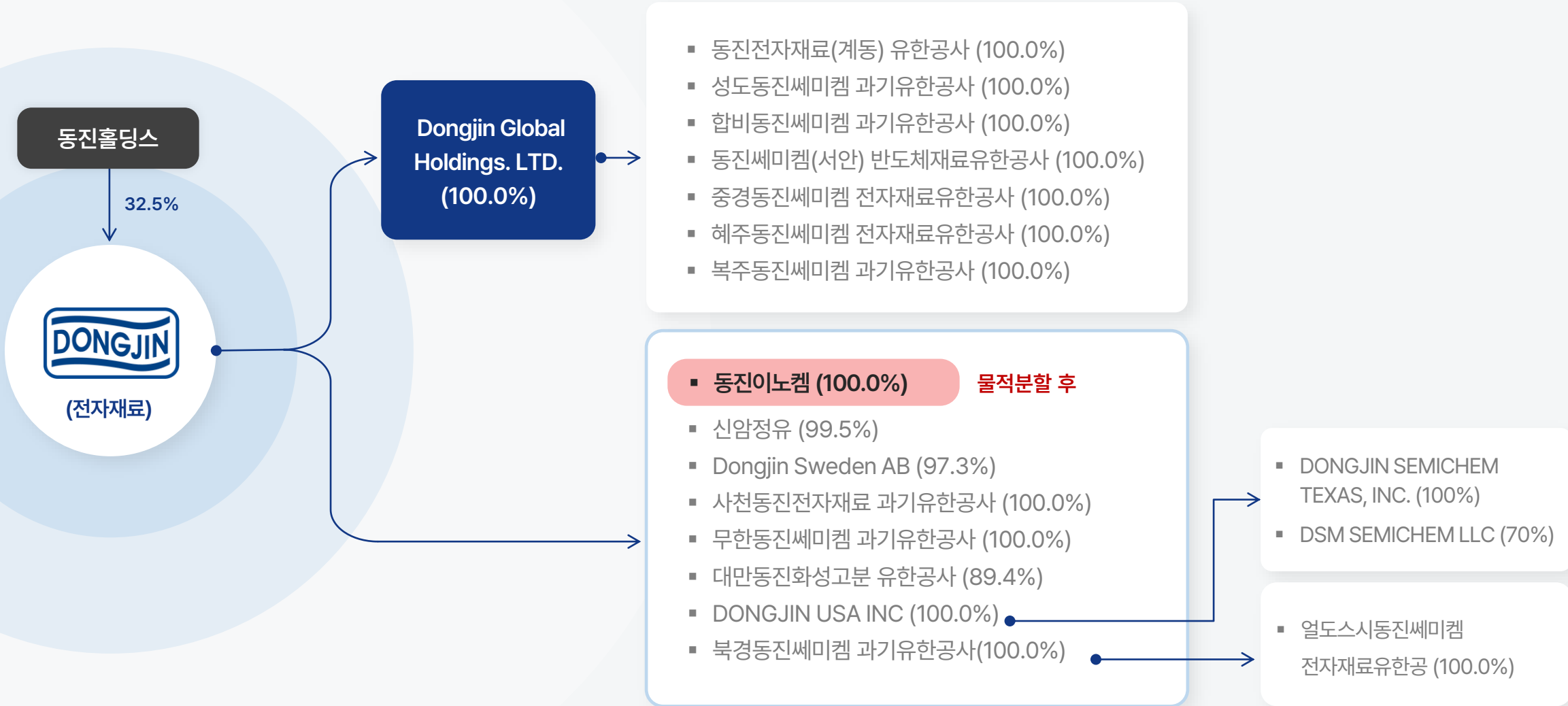
1967년 발포제 사업으로 창업, 정밀화학분야의 선두기업

History & Governance





History & Governance



01. Prologue



Global Network - Office/Factory

스웨덴 Sweden

DONGJIN SWEDEN AB

중국 China

- 북경동진세미켄과기유한공사
- 동진전자재료(계동)유한공사
- 성도동진세미켄과기유한공사
- 합비동진세미켄과기유한공사
- 동진세미켄(서안)반도체재료유한공사
- 얼도스시동진세미켄전자재료유한공사
- 중경동진세미켄전자재료유한공사
- 혜주동진세미켄전자재료유한공사
- 북주동진과기유한공사
- 사천동진전자재료과기유한공사
- 무한동진세미켄과기유한공사
- 심천 사무소

미국 USA

- DONGJIN USA INC
- DSM SEMICHEM LLC
- DONGJIN SEMICHEM Texas INC

대만 Taiwan

대만동진화성고분유한공사

인도네시아 Indonesia

PT. DONGJIN INDONESIA

서울

서울본사

경기도

- 발안공장
- 인천공장
- 시화공장
- 판교연구소
- 파주사무소

경상북도

구미사무소

충청북도

- 음성공장
- 동진첨단소재

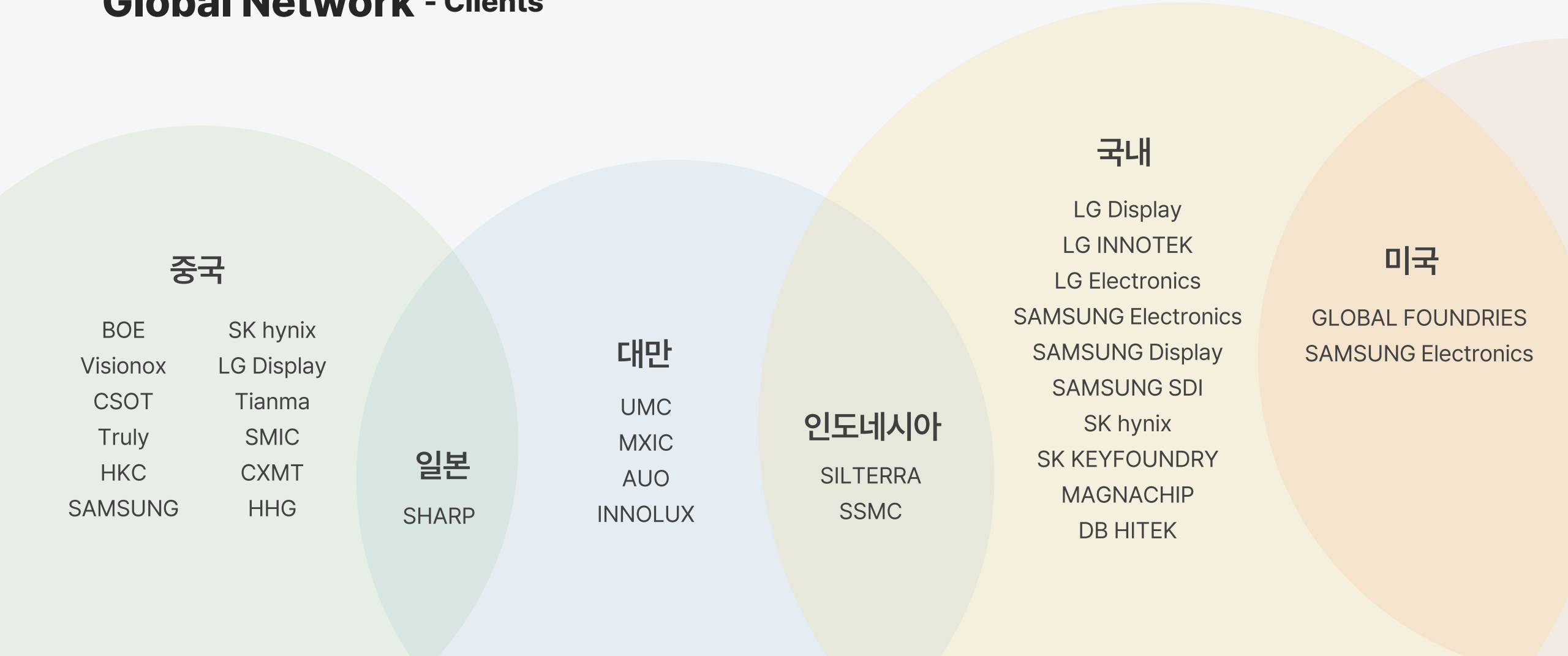
충청남도

신암정유(관계사)

해외 사업장 18개, 사무소 5개

국내 사업장 4개, 사무소 4개, 종합연구소 1개

Global Network - Clients



Core Business & Competitiveness

- Semiconductor Materials
 - Display Materials
 - Growth Strategy & Momentum
 - 투자 포인트(Why Invest)
-

Semiconductor Materials

끊임없는 신소재 개발과 반도체 공정 소재 기반기술을 확보하여 세계 최고의 한국 반도체 산업을 든든히 뒷받침하고 있습니다.



반도체 Thinner
국내 시장 점유율 1위

- 국내 최초 1M Photoresist 개발
- CMP Slurry 국내 최초 개발 및 상업화
- ArF Imm'Photoresist 국내 최초 상업화
- 3D NAND용 KrF Photoresist 세계 시장 점유율 1위
- 반도체 Thinner 국내 시장 점유율 1위

주요 제품군

1. 포토레지스트
2. 신너
3. CMP 슬러리
4. 반사방지막
5. 하드마스크
6. 프리커서
7. 황산

✓ 사업분야 소개

동진세미켄은 1984년 반도체용 봉지재 사업을 시작으로 1989년 Photoresist를 국내 최초 개발하고, 현재 EUV Photoresist 양산에 성공하였다. 이후 다양한 반도체 공정 소재를 개발해 국내외 고객사에 공급하고 있다.

수입 의존 소재의 국산화를 선도하며 세계 선진사들과 경쟁하고 있으며, 신소재 개발과 공정 소재 기술 확보로 한국 반도체 산업을 뒷받침하고 있다.

Semiconductor Materials

✓ 주요 제품군

01. 포토레지스트 | Photoresist

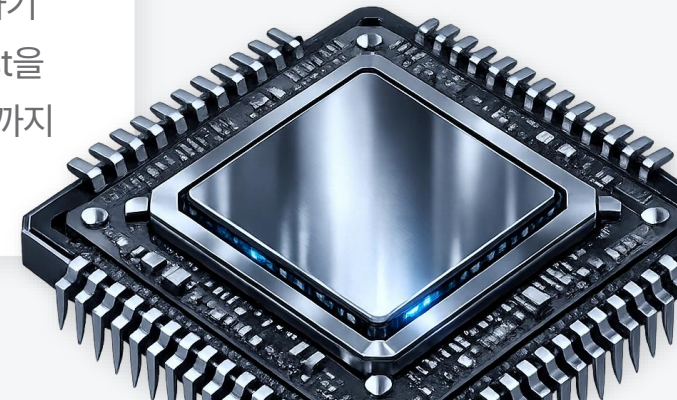
포토레지스트란 특정한 파장의 빛에 반응, 화학적 변화를 일으킨 후 화학적 성질의 변화를 이용하여 특정한 선폭(패턴)을 전사할 수 있게 하는 구성물로서, 반도체 회로소자 제조 공정 중 Lithography 공정에 사용되는 핵심 재료입니다.

02. CMP 슬러리 | CMP Slurry

CMP란 Wafer 표면에 Slurry를 공급해 화학적으로 반응시키면서 기계적으로 Wafer 표면을 평탄화시키는 기술입니다. Slurry 종류는 연마대상 막질에 따라 크게 Oxide Slurry와 Metal Slurry 및 유기막 Slurry로 구분이 되며 Abrasive 종류 및 기능에 따라 세분화 됩니다.

03. 신너 | Thinner

Semiconductor Thinner는 Photoresist Spin Coating 후 실리콘 웨이퍼 가장자리의 불필요한 Photoresist를 제거하기 위해 EBR (Edge Bead Removal) 공정에 사용됩니다. 또한 RRC(Resist Reduced Coating) 공정을 통해 Photoresist를 코팅시 Photoresist의 사용량을 줄이는데도 사용됩니다. 동진 신너는 일반 신너에 비해 Photoresist의 사용량을 50% 까지 효과적으로 줄일 수 있으며 Hump Height를 감소할 수 있어서 수율을 증대 할 수 있습니다.



Semiconductor Materials

04. 반사방지막 | Bottom Anti-reflective Coating

반사방지막은 Photoresist를 이용한 회로 형성 공정에서 노광된 빛의 하부 반사 및 산란의 제어를 통해 공정상의 문제점인 Standing Wave, Notching 등을 억제하여 미세회로를 구현할 수 있도록 하는 재료입니다.

05. 하드마스크 | Spin-on-carbon Hardmask

미세회로 형성을 위해 Photoresist Film의 두께가 얇아짐에 따라 Etch 공정에서 Photoresist만으로 Mask 역할의 수행이 어려워, Etch Masking 재료로서 도입된 물질로 차세대 반도체 제조에 필수적인 재료입니다.

06. 황산 | Sulfuric Acid

고순도 황산은 고순도 과산화수소와 일정 비율로 혼합하여 반도체 Wet Cleaning 공정 중 SPM(Sulfuric Peroxide Mixture) 공정에 사용되며, Photoresist 잔유물과 같은 유기물 및 금속성 오염물을 제거하는 역할을 합니다.

07. 프리커서 | Precursor

초고품질의 박막 증착용 공정인 CVD/ALD의 원료가 되는 물질로, 금속 박막, 금속 및 실리콘의 산화막, 질화막 등을 월등한 Step Coverage로 증착 가능한 물질입니다.

Display Materials

동진세미켐의 디스플레이 사업은 우리나라 LCD 산업의 급성장에 대응하기 위하여 1991년에 시작되었습니다.



유기절연막
국내 시장 점유율 1위

- 유기절연막 국내 최초 개발
- LCD용 PR 국내 최초 개발
- 4-Mask PR 세계 최초 양산 성공
- LCD PR용 Stripper 국내 최초 개발
- 인셀터치용 배면전극재료 세계 최초 양산

✓ 사업분야 소개

당사는 일본 및 글로벌 기업이 원천기술을 보유한 상황에서 자체 기술개발로 포토레지스트(Photoresist), 스트리퍼(Stripper), 에천트(Etchant), 신너(Thinner) 등을 개발·국산화하며 국내 디스플레이 제조원가 개선과 경쟁력 확보에 기여하였다.

이후 소재 국산화를 넘어 미세화, 수율 향상, 공정 개선을 위한 신규 소재 개발을 통해 차별화된 제품 개발에 기여하였다. 또한 신소재 및 원가혁신 소재 개발을 통해 한국 디스플레이 산업 성장에 기여하였다.

주요 제품군

1. 유기절연막
2. 포토레지스트
3. 스트리퍼
4. 에천트
5. 컬러레지스트
6. 배면전극재료
7. 하드코팅
8. OLED 온셀 터치용 재료
9. OLED 증착용 유기재료
10. 광학투명 레진

Display Materials

✓ 주요 제품군

01. 유기절연막 | Organic Insulating Layer Materials

TFT에서 투명 전극과 데이터 라인의 혼선을 막는 역할을 하여 데이터 라인 근처에 위치한 투명한 픽셀 전극을 통하여 패널의 개구율을 향상시켜 휘도를 높이는 용도로 사용하고 있습니다.

02. 포토레지스트 | Photoresist

특정한 파장의 빛에 반응하여 화학적 변화를 일으킨 후 물리적, 화학적 성질의 변화를 이용하여 특정한 선폭(Pattern)을 전사할 수 있게 하는 고분자 화합물로, TFT-LCD 회로 소자 공정 중 노광(Lithography) 공정에 사용되는 핵심 재료입니다.

03. 스트리퍼 | Stripper

LCD 및 OLED panel을 제조할 때 사용된 PR과 제조공정 중에 발생하는 각종 유기 이물을 제거하고, 형성된 금속배선의 부식을 방지하는 재료입니다.

04. 에천트 | Etchant

산(Acid)을 이용하여 이종 다층막 구조의 금속을 일괄 또는 선택적으로 제거하여 미세회로 배선을 형성하는 식각공정에 적용되는 재료입니다.

05. 컬러레지스트 | Color Resist

Backlight에서 나온 빛을 Red, Green, Blue를 구현하는 안료를 포함한 유기 조성물로, RGB가 화소마다 번갈아 존재하여 전기적 신호를 받아 원하는 색의 빛을 만드는 재료입니다.

Display Materials

06. 배면전극재료 | Background Electrode Materials

전극의 배면에 전도성 고분자를 코팅하여, 발생하는 정전기를 전도성 고분자에서 소멸시켜 터치 감도를 높이고, 내부 부품들을 보호하는 재료입니다.

07. 하드코팅 | Hard Coating

강도/내열성/화학적 안정성이 우수한 무기 세라믹과 연성과 탄성이 뛰어난 유기 고분자를 결합한 유무기 하이브리드 코팅제를 플라스틱 표면에 처리하여, 강화유리 수준의 경도를 구현하면서도 무게는 유리의 절반 이하이고 깨지지 않는 기판을 구현하는 재료입니다.

08. OLED 온셀 터치용 재료 | OC, PR

OLED에서 Cell 상에 터치 센서를 형성하기 위해 사용되는 재료들로 저온 공정용 PR은 투명 전극과 회로 형성에 사용되는 재료입니다. 저온 공정용 OC(Over Coat)는 형성된 터치센서를 보호하기 위한 재료입니다.

09. OLED 증착용 유기 재료 | CPL, HTL Prime

OLED의 광효율을 증가하기 위한 증착 공정용 재료들로 CPL(Capping Layer)은 전면발광 소자에서 고굴절과 열안정성이 우수한 재료입니다. HTL Prime 재료는 양극과 음극 사이에서 정공의 이동을 돕는 재료입니다.

10. 광학 투명 레진 | Optical Clear Resin

디스플레이 패널 보호용 Cover Window를 합착하기 위해 사용되는 재료로, Cover Window와의 접착력이 우수하여 비산 방지 기능을 하며, 화질 측면에서 Contrast와 휘도를 향상시켜 소비전력을 낮출 수 있는 재료입니다.

Growth Strategy & Momentum



2차전지 소재 사업의 본격화

노스볼트 등 주요 고객사 향 CNT 도전재,
실리콘 음극재 등 배터리 소재 개발 및
공급 계획

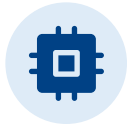
차세대 반도체 공정 대응 R&D

하이엔드 반도체 미세화에 따른
차세대 소재 R&D 로드맵

글로벌 증설 계획

늘어나는 수요에 대응하기 위한 국내외
(미국, 유럽 등) CAPEX 투자 및
생산 능력(CAPA) 확대 로드맵

투자 포인트 (Why Invest)



투자 포인트 01
**반도체 소재 위주의
성장 지속**

3D NAND 고단화 공정에 필수적인 KrF 포토레지스트의
글로벌 1위 지배력 과 차세대 EUV PR의 독점적 국산화 성공을 통해,
시장 내 반도체 핵심주로서의 위상 공고히 함



투자 포인트 02
거버넌스 개선

지배구조 개선을 통한 경영 투명성 확보를 기점으로 공격적인
주주환원 정책을 실행하여 시장의 신뢰를 회복하고 기업 가치를
근본적으로 재평가



투자 포인트 03
미국시장 진출

약 2,600억원이 투입된 미국 텍사스 신규 거점이 2026년 하반기
양산을 시작함에 따라, 글로벌 파운드리 고객사 공급 본격화와 함께
2027년 이후 폭발적인 외형 성장 및 실적 모멘텀을 확보할 전망

Financial Performance



-
- Financial Summary
 - Financial Structure
 - Shareholder Return
-

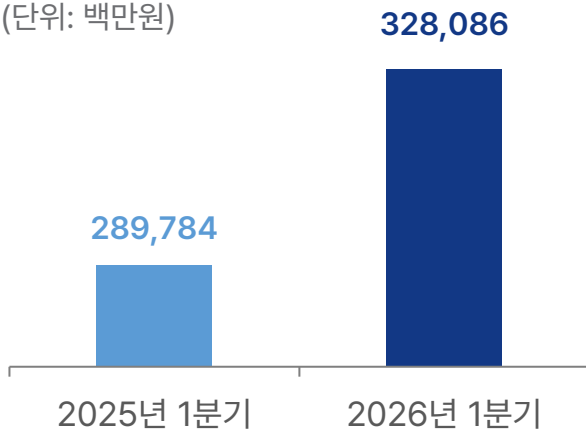
Financial Summary

✓ 주요 지표

2026년 1분기 매출액
전년 동기 대비 **+12.2% 증가**

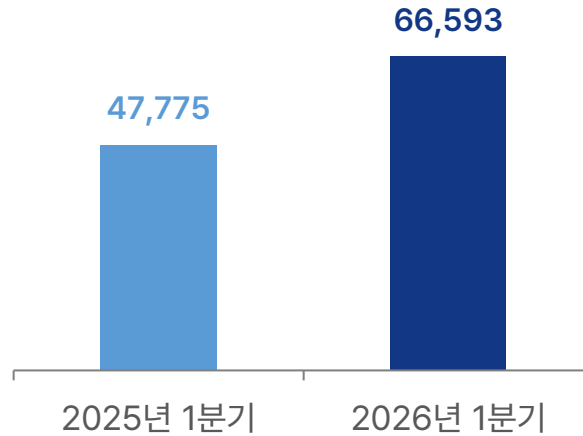
반도체 소재(PR, 신너) 물량 증가 및
환율 상승(평균환율 1,452.96 → 1,464.66)

(단위: 백만원)



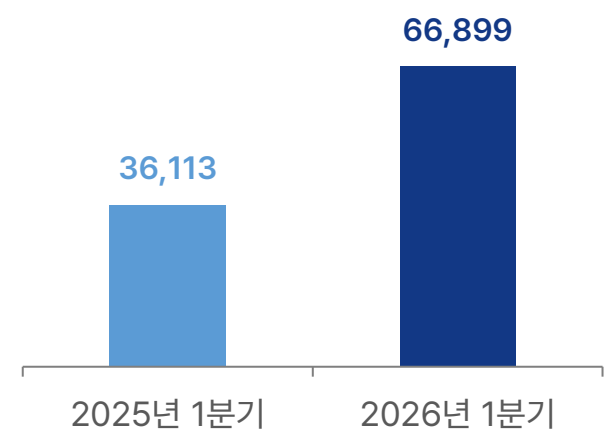
2026년 1분기 영업이익
전년 동기 대비 **+39.4% 증가**

환율 상승 및 매출원가 개선을 통한
이익율 상승



2026년 1분기 당기순이익
전년 동기 대비 **+85.2% 증가**

매도가능증권(삼성전자) 평가 이익 및
외환이익, 외환평가이익 증가



Financial Summary



당사는 25년 3분기 중 지배기업 및 종속기업의 중국법인 지분 100%를 매각하기로 결정하였습니다.
(100% 매각 후 전체지분의 30% 재매수 조건).

기업회계기준 제1105호에 따라 관련 자산 및 부채를 매각예정으로 분류하였으며,
매각예정법인의 매출액 및 영업이익을 중단영업손익으로 반영하여 재무제표를 공시 하였습니다.

중단영업손익을 미반영한 연결손익은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
매출액	368,108	376,841	383,702	395,346	416,879
영업이익	58,461	53,838	52,339	54,967	78,582
당기순익	36,113	5,481	23,179	29,320	66,899

Financial Structure

✓ 재무상태표 (연결)

(단위: 백만원)

	2024년 말	2025년 말	2026년 1분기
유동자산	1,082,971	1,130,911	1,231,442
비유동자산	934,018	875,219	919,453
자산 합계	2,016,989	2,006,131	2,150,894
유동부채	722,769	579,367	651,354
비유동부채	273,790	325,183	353,790
부채 합계	996,558	904,550	1,005,144
자본 합계	1,020,431	1,101,581	1,145,751
부채비율	98%	82%	88%
유동비율	150%	195%	189%
유동부채비율	71%	53%	57%

Shareholder Return

배당 이력

배당성향 25% 이상을 지속적으로 유지하도록 목표

구분	2023년 51기	2024년 52기	2025년 53기
주당액면가액(원)	500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)	127,315	154,782	99,070
(별도)당기순이익(백만원)	129,293	80,019	131,742
현금배당금총액(백만원)	6,170	10,283	33,400
주당 현금배당금(원), 보통주	120	200	650

자사주 소각

당사는 2025년 12월 8일 자기주식 200억원 매입을 공시하고 2026년 4월 중 매입을 완료하였습니다.
매입한 자기주식은 현재기준 전량 소각하였습니다.



주주 환원 정책

현금배당 중심의 주주환원 정책을 늘리도록 노력하겠습니다.



Appendix

- 경영진 소개
 - ESG 경영 현황 (환경, 사회, 지배구조)
 - 주주 구성 요약 및 재무제표
-

Silicon Park
실리콘 파크

(주)동진세미켄
DONGJIN SEMICHEM

직책	성함	학력	이력
대표이사	이준혁	<ul style="list-style-type: none"> • 서울대 화학공학 학사 • M.I.T 화학공학 박사 	<ul style="list-style-type: none"> • 동진씨미켄 회장 • 월드클래스기업협회 회장 • 한국반도체 산업협회 부회장 • 한국공학한림원 이사
사내이사	김성일	<ul style="list-style-type: none"> • 중앙대 전자공학 학사 	<ul style="list-style-type: none"> • 동진씨미켄 사장 • 삼성전자 메모리사업부 그룹장
사내이사	김재현	<ul style="list-style-type: none"> • 서울대 섬유공학 석사 • 메사추세츠 주립대 고분자과학 박사 	<ul style="list-style-type: none"> • 동진씨미켄 사장
사외이사	이승종	<ul style="list-style-type: none"> • 서울대 화학공학 학사 • University of Delaware 화학공학 박사 	<ul style="list-style-type: none"> • 서울대 화학생명공학부 명예교수 • KDB 나눔재단 이사
상근감사	조명재	<ul style="list-style-type: none"> • 서울대 상과대학 학사 	<ul style="list-style-type: none"> • LG생활건강 대표이사 • LG미소금융재단 이사장

지속가능 기업으로 거듭나기 위해

친환경, 사회적 책임, 투명한 지배구조 중심의 경영 실천



고객만족, 지역사회 소통, 협력사 동반성장

- 지역사회 인프라 증진활동
- 커뮤니케이션 활성화
- 협력사 역량강화 및 동반성장
- 미래기술 협력
- 공정거래

다음 세대를 위한 친환경 사업장 운영 및 제품 생산

- 유해물질 사용 원천 차단
- 사업장 환경영향 최소화
- 환경오염물질 배출 관리
- 폐기물 재활용 및 재사용
- 전 사업부문 에너지/온실가스 관리
- 환경친화적 생산공정

경영 안정성, 윤리경영, 회계 투명성

- 윤리경영 시스템 운영
- 내부회계 관리제도 외부감사
- ESG 경영을 위한 TFT 운영
- 안정적 경영을 위한 지분율 확보

주주명부 (2026.03.31 기준)

주주명	주식수('26년 1분기말)	지분율
동진홀딩스주식회사	16,706,986	32.49%
재단법인 동진장학연구재단	1,880,000	3.66%
명부산업(주)	633,678	1.23%
옥연수	210,560	0.41%
안상희	206,500	0.40%
삼성전자	2,467,894	4.80%
기타	29,308,876	57.01%
합계	51,414,494	100.00%

감사합니다

MEMO

A large, empty white rectangular area with rounded corners, intended for writing a memo. The area is completely blank and occupies most of the page below the 'MEMO' header.

